

胡志明市布局半導體產業，聚焦人才與產學合作機制

駐胡志明市辦事處教育組

2026年3月20日下午，胡志明市半導體產業協會（HSIA）與胡志明市創新創業中心（SIHUB）共同舉辦「政府、教育機構與企業三方合作機制」研討會，聚焦政策制定、研究發展、人才培育及電子與半導體產業推動等面向之協作模式。胡志明市科學技術廳表示，市政府正規劃自先前評估之15處地點中，篩選設立12個集中式數位科技園區，總面積約994.45公頃。其中，北部地區（原平陽省）將作為科技城市發展核心區域。若以約1,000公頃土地打造完整產業聚落，預估每年可創造約160億美元產值，平均每公頃年產值約達1,500萬至1,600萬美元，並可於2030年前貢獻胡志明市數位經濟目標約27%，同時創造約80.5萬個科技相關就業機會。

為吸引企業投資，胡志明市亦規劃多項租稅與行政優惠措施。包括企業所得稅最長4年免稅、後續9年減半徵收，以及研發支出最高可達200%之扣稅優惠。在基礎設施方面，企業於專案期間可享全額免除土地租金；對於國內尚未生產的設備，可免徵進口稅，並透過「綠色通道」優先辦理海關程序。

同時，市府也提出由國家預算支持的四類措施，以強化產業自身發展能力。在人力資源方面，提供專家聘用費50%補助（每人每月最高不超過6,000萬越南盾，最長36個月），以及培訓費50%補助（每人每課程最高不超過2億越南盾）。針對配套產業企業，每項專案最高可獲20億至30億越南盾補助。在晶片設計領域，亦規劃多項補助措施，包括研發費用補助70%（上限150億越南盾）、設備投資補助50%（上限200億越南盾），以及多專案晶圓（MPW）試產費用最高可獲全額補助；至於AI人工智慧資料中心等重點專案，最高可提供總投資額10%的補助，單一專案上限為2,000億越南盾。

在產學合作方面，胡志明市國家大學所屬百科大學副校長範陳宇（Phạm Trần Vũ）指出，目前由政府主導的研究計畫雖具規模且著眼長期發展，但在行政流程、經費運用及智慧財產權安排上仍有限制，

可能影響企業參與意願；相對而言，由企業主導的研發模式雖較具彈性且貼近市場需求，但多偏向短期應用，較難累積關鍵技術。

範副校長表示，目前發展方向已相當明確，關鍵在於如何建立有效整合各方資源的合作架構，這也成為半導體研發推進的一項主要限制，尤其在晶片設計與核心技術等高附加價值領域更為明顯。因此，建議加快建立政府、學研機構與企業之間的合作架構，明確界定權責與利益分配，同時放寬相關行政與經費使用規定，以提高整體運作彈性。此外，也應加強人才培育與產業需求之間的連結，並持續投入關鍵研究設施，特別是建立具協調功能的平台，例如產業聯盟，以促進長期穩定合作。

從國際經驗來看，越南 Letuin 公司總經理金容泰(Yong Tae Kim)建議，越南應採取較為務實的發展策略，優先聚焦於晶片設計與終端應用等可行性較高的環節，而非一次鋪展整體製造鏈，同時建立結合理論、模擬與企業實習的培育方式，協助學生順利銜接學習內容與產業實務。

撰稿人/譯稿人：林韋至

資料來源：2026 年 03 月 20 日，年輕電子報；

<https://tuoitre.vn/go-diem-nghen-ban-dan-mo-hinh-nao-se-phu-hop-cho-tp-hcm-20260320191101815.htm>